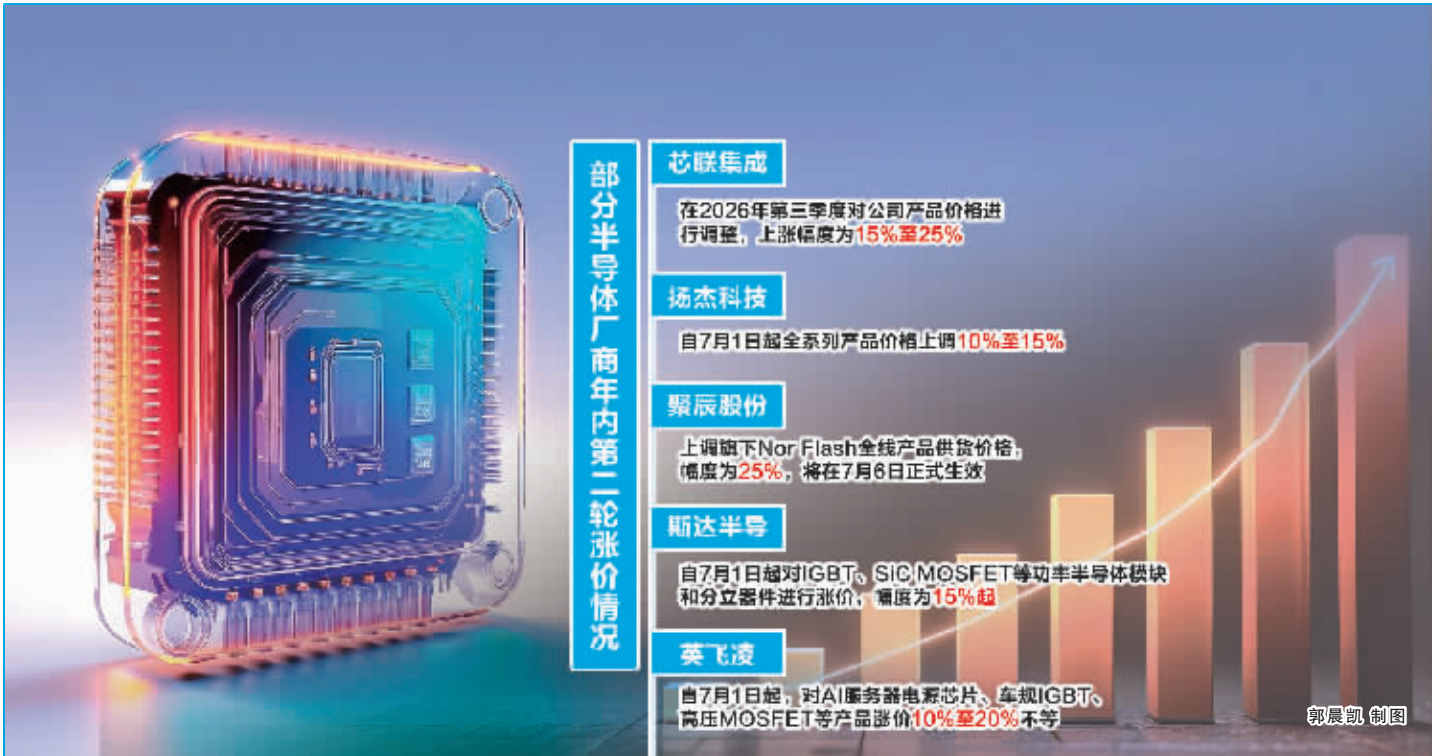




成本上涨与市场需求双轮驱动 半导体开启年内第二轮涨价

◎记者 李兴彩

7月起，全球半导体行业迎来新一轮价格调整。

上海证券报记者获悉，近日，芯联集成、斯达半导、扬杰科技、聚辰股份等多家半导体公司向客户发出了涨价函，价格上调幅度为15%至25%。

芯联集成6月30日发布涨价函称：受成本上涨因素影响，叠加AI、新能源等需求爆发，公司产能持续紧张。为持续保障产品品质与供应稳定，决定在2026年第三季度对公司产品价格进行调整，上涨幅度为15%至25%，这也是公司年内第二轮提价。

扬杰科技宣布，自7月1日起全系列产品价格上调10%至15%，这是该公司继3月下旬调整部分产品报价后的年内第二轮调价。同时，聚辰股份对客户发函，确定上调旗下Nor Flash全线产品供货价格，统一在当前执行价格基础上上调25%，新价格体系将在7月6日正式生效。

此前，德州仪器（TI）、英飞凌、意法半导体（ST）等海外大厂已经宣布7月开启年内第二轮涨价，提价产品覆盖信号链产品、电源模拟芯片、数据中心及新能源车用功率半导体等。比如，英飞凌表示，自7月1日起，对AI服务器电源芯片、车规IGBT、高压MOSFET等产品涨价10%至20%不等。

“国内多家功率模拟半导体公司在2月至5月发布了第一轮涨价函，下半年也都会开启新一轮涨价，部分企业不再单独下发正式书面涨价函，仅通过商务邮件告知客户调价安排。”有模拟芯片公司在接受记者采访时表示，其已经给客户发出了下半年涨价的邮件。

据记者不完全统计，超过20家国内外半导体公司在上半年发布了第一轮涨价函。目前，相关公司均宣布了新一轮涨价通知。细看各家公司的涨价通知函，成本上涨、AI需求爆发是调价的核心诱因。

比如，斯达半导表示，受晶圆制造、大宗金属、封装等材料价格上升影响，公司产品制造成本持续大幅增加，目前成本压力已超出内部可消化的范围。公司决定自7月1日起，对IGBT、SiC MOSFET等功率半导体模块和分立器件进行涨价，调价幅度为15%起。

相较于成本上涨，需求端拉动作用更为突出。据了解，AI算力、新能源汽车带动功率半导体市场需求持续高增长，功率与模拟半导体赛道，已成长为继AI算力芯片、半导体设备之后的第三条产业投资主线。

公开资料显示，单台AI服务器的功率半导体使用量是传统服务器的3倍以上，部分高端机型可达5倍以上。充电桩新能效国标将于2026年11月1日起实施，叠加

汽车市场800V高压平台渗透率提升、储能装机需求持续增长，碳化硅器件在下游场景的规模化导入大幅提升。

有功率半导体业内人士表示，本轮模拟、功率半导体需求呈现显著结构性分化特征：AI、车规、工控等高可靠芯片需求火爆，而消费电子类芯片市场持续低迷。“市场需求不区分产品高中低端，核心看芯片是否适配AI相关功能场景，具备AI配套能力的芯片订单均保持高景气。”该功率半导体业内人士称，扬杰科技在近日接受机构调研时表示，公司SiC业务目前在手订单饱满，产销维持良好态势，产能利用率处于高位，正同步推进产能扩建。

“产业链各个环节都在涨价推高生产成本，叠加上游需求持续旺盛、上游晶圆产能供给偏紧，芯片正从结构化涨价迈入价格普涨的阶段，预计所有的芯片都会涨价。”有半导体业内人士表示，当前，下游市场需求持续向好，英飞凌多款核心产品交付周期拉长至数月，国内功率半导体公司产能普遍趋于紧张。

记者采访获悉，目前光储、汽车、AI数据中心的需求全面旺盛，包括碳化硅在内的模拟和功率芯片产品普遍供不应求，头部企业订单能见度可覆盖较长周期。与下游需求持续扩容形成反差的是，预计下半年主流晶圆厂的产能紧张态势或将进一步加剧。

国巨电容涨价 机构预计更多MLCC原厂将跟进

◎记者 孔令仪

7月1日，市场传闻被动元件大厂国巨向客户端通知价格调整，自当日开始调涨全系列电容产品价格，包括钽电、MLCC（片式多层陶瓷电容器）、铝电、固态铝电、薄膜电容、超级电容等，涉及的产品覆盖国巨约50%营收，且涨价对象首次纳入直接客户（EMS/OEM）。

对此，上海证券报记者致电东莞市超翔电子有限公司、深圳市河锋鑫科技有限公司等多家国巨代理商进行求证，相关代理商均表示，国巨全系列电容产品涨价属实，且本次调涨的对象从代理商扩展至直接客户，等同现货价、合约价同步调涨。

中信证券认为，在国巨带动下，会有更多MLCC原厂落地涨价动作，今年7月前后原厂密集涨价潮将渐次落地。该机构预测，本轮MLCC涨价周期有望延续超过一年，幅度可能翻倍甚至更多。华创证券电子联席首席分析师岳阳也表示，AI服务器正在把MLCC从传统被动元件，重新定价为算力基础设施中的关键瓶颈物料。

MLCC原厂涨价，现货市场情况如何？深圳市河锋鑫科技有限公司工作人员告诉记者，国巨电容产品本次原厂价格涨幅大约为50%，现货市场的价格涨幅会更大。“这次是原厂通知涨价，实际上，现货市场从今年5月到现在一直在涨价，高端电容产品的价格一个月时间内最高涨幅接近10倍。最近经常出现延迟供货的情况，除了国巨，MLCC各大品牌都有延迟供货。”该工作人员说。

记者实探华强北了解到，市场对村田、三星电机、太阳诱电等品牌MLCC涨价情况关注度最高，国巨受到关注度相对较低。业内人士认为，国巨此次宣布全系列电容涨价，意味着AI服务器正在重塑被动元件需求，被动元件景气度正从单一的MLCC向更多电容品类扩散。

18家半导体公司IPO同日获受理 展现细分领域“芯”实力

◎记者 李兴彩

6月30日，18家半导体公司IPO申请同日获交易所受理。

上海证券报记者梳理发现，这18家公司各有千秋，且不乏细分领域的龙头，显示出国产半导体在量检测设备、天车、第三代半导体材料、光通信等多个领域的新进展、新突破，展现了“强链、补链、延链”的新成效。

18家公司IPO申请同日获受理

半导体公司IPO迎来新一轮“小高潮”。据记者统计，6月30日，集益威、华卓精科、同创普润、天科合达、东方晶源、世维通、维安股份、莱普科技、神州股份、上海隐冠、羲禾科技、弥费科技、鲁汶仪器等13家半导体公司IPO申请获上交所受理。同日，云豹智能、度亘核芯、宸芯科技、华普微、法特迪等5家半导体公司IPO申请获深交所受理。

上述18家公司中，半导体设备类（包括零部件）公司占比最高，包括华卓精科、东方晶源、莱普科技、神州股份、上海隐冠、弥费科技、鲁汶仪器。

其中，华卓精科为二度冲刺IPO，其主营业务以超精密测控技术为基础，研究、开发及生产超精密测控设备部件、超精密测控设备整机并提供相关技术开发服务。公司曾于2020年6月申报科创板IPO并获受理，2021年9月通过上市委审议。后基于整体市场环境及自身资本运作发展规划，公司于2024年6月主动撤回IPO申请。

上海隐冠专业从事精密运动平台及核心零部件的研发、生产与销售，精密运动平台是半导体检测、晶圆键合等关键设备中的关键子系统，也是我国半导体产业链需要攻坚的关键环节之一。

获受理的2家半导体材料公司同样可圈可点。同创普润在先进金属材料技术研发和产业化方面取得突破，形成了超高纯4N5-6N钼、6N铝、7N铜、5N钕及相关高纯高性能金属材料的生产能力，核心产品服务于集成电路和显示两大行业。天科合达打破了海外厂商对碳化硅衬底的长期垄断，已成长为碳化硅材料领域的全球领军企业之一，2023年以来核心产品导电型碳化硅衬底市场占有率均排名全球前三。

云豹智能成为又一家选用创业板第四套上市标准申报上市的企业。根据招股说明书，以2025年收入计算，云豹智能在中国全功能DPU（数据处理器

芯片）市场排名国产独立厂商第一。

细分领域龙头展现“芯”实力

与以往不同，本次获受理的多家半导体公司是资本市场的“生面孔”，但又是其所在细分领域的佼佼者，显示出中国半导体产业发展的纵深度，展现了“强链、补链、延链”的新成果。

随着AI算力发展，高速互联成为新产业瓶颈。集益威在高速互联领域已形成互连接口（SerDes）、模数和数模转换器（ADC/DAC）、锁相环（PLL）和数字信号处理（DSP）等四大核心技术，自研的多款高速互联芯片、定制专用（ASIC）芯片，已成功实现可支持400G/800G光模块应用的高速光数字信息处理（oDSP）芯片、支持400G/800G以太网数据传输的板级中继（Re-timer）芯片的产业化。

在国产半导体设备的最短板之一——量检测设备领域，东方晶源正在脱颖而出。

东方晶源以“电子束量检测设备+计算光刻软件”为双核心，构建起软硬件协同的良率管理解决方案，成功研发并在产线应用多款电子束量检测设备，是国内电子束量检测设备领域产品布局最齐全的企业。

据Yole统计，半导体量检测设备价值量占半导体前道设备的比例约为13%，仅次于刻蚀及清洗设备、薄膜沉积设备和光刻机，也是前道设备中国产化率最低的品类之一。其中，在电子束量检测设备领域，2025年，应用材料、日立高新、阿斯麦-汉民微测、科磊半导体等合计占据了全球超过85%的市场份额。

同样在设备领域展现出“补链”价值的还有国产天车龙头公司弥费科技。

弥费科技披露，历经多年的持续研发，公司逐步推出了晶圆存储设备、上下料口净化设备、光罩存储设备、空中缓存单位、天车传送系统等共三大类三十余款硬件设备及自研MCS等工业控制软件，是国内少数具备半导体AMHS（自动物料传送系统）各类产品自研与供应能力的厂商。

AMHS是直接影响半导体晶圆厂生产效率和产品良率的核心系统之一，约占到半导体设备价值总量的3%。弥费科技援引Gartner数据披露，2025年，日本大福集团和村田机械合计占有全球AMHS市场约90%的份额，三星下属公司SEMES市场占有率约为9.1%（主要服务三星电子和三星显示），弥费科技市场占有率约为1.6%。

“三元+磷酸系”双线布局谋新程 金川瑞翔冲刺创业板IPO

◎记者 李少鹏

三元正极材料龙头企业甘肃金川瑞翔新材料股份有限公司（下称“金川瑞翔”）IPO有新进展。

深交所官网显示，金川瑞翔创业板IPO申请已于6月29日获受理。据招股书，2025年三元正极材料出货量居全球首位，年度营业收入超过200亿元的金川瑞翔，计划募资37.8亿元加码高压实磷酸铁锂正极材料产能，以期实现“三元做强，磷酸系做大，前沿布局”的产业目标。

金川瑞翔隶属于我国镍钴龙头企业金川集团，后者已构建起“矿产冶炼—核心材料—资源回收”垂直一体化产业链，为金川瑞翔在原料供应、产业协同等方面提供有力支持。

三元龙头冲刺IPO “朋友圈”阵容豪华

招股书显示，金川瑞翔成立于2006年，公司深耕锂电池正极材料领域二十年，构建了全品类产品矩阵，其中以三元正极材料特别是中镍单晶高电压产品为行业标杆，国内市场占有率超过50%。

金川瑞翔拥有江苏南通和甘肃兰州两大生产基地，截至2025年末，南通基地拥有三元材料产能20.26万吨、磷酸铁锂产能3.6万吨，兰州基地10万吨磷酸铁锂产能已于今年1月建成并逐步投入运营。

目前，金川瑞翔的核心竞争力在于中镍单晶高电压三元材料。2023年至2025年，公司三元材料年出货量从5.01万吨增至18.60万吨。据高工产研数据，2025年公司三元正极材料出货量居全球首位，市场份额达到16.4%。在中国6系三元材料细分赛道，公司市占率高达53.94%；单晶产品产量占市场总产量的37%，均位居行业第一。

翻看招股书可见，金川瑞翔“朋友圈”堪称豪华，2025年斩获宁德时代年度“优秀供应商”大奖。除与宁德时代建立深度合作外，公司产品覆盖比亚迪、欣旺达、三星SDI、日本东芝等国内外知名电池厂商，产品终端配套鸿蒙智行、小米汽车、理想汽车、蔚来汽车、极氪汽车等多家知名品牌高端车型。

财务数据方面，金川瑞翔2023年至2025年分别实现营业收入106.85亿元、128.46亿元和211.18亿元，分别实现净利润-6.92亿元、2.26亿元和7.17亿元。

对于2023年的亏损，公司解释称，主要系2023年上游原材料价格剧烈波动，氢氧化锂价格从50万元/吨以上跌至10万元/吨以下，叠加行业景气度下滑，导致当期业绩亏损。

加码磷酸铁锂产能 双线布局打开成长空间

近年来，随着磷酸铁锂技术不断突破，其市场份额的持续攀升对三元材料构成了最直接的威胁。

在行业打拼多年的金川瑞翔感受明显，此次IPO也将募投重点放在磷酸铁锂产能建设方面。据招股书，金川瑞翔拟募资37.8亿元，投向20万吨/年

磷酸系锂离子电池正极材料生产线建设项目（二期）以及30万吨/年磷酸系锂离子电池正极材料生产线建设项目。

公司表示，募投项目聚焦高压实密度的第4代磷酸铁锂产品的规模化产能建设，建成后公司将具备50万吨以上高压实磷酸铁锂产品的规模化供应能力，满足下游动力与储能领域不断增长的市场需求，完善公司核心产品矩阵。

记者了解到，金川瑞翔对于磷酸铁锂布局已久，主要由控股子公司金麟锂电负责实施。其中，20万吨/年磷酸系锂离子电池正极材料一期10万吨产线已于今年1月顺利投产。待二期项目建成，整体达产后预计年产值将超过60亿元。

虽然金川瑞翔颇有磷酸铁锂“新兵”的意味，但得益于下游需求爆发式增长，公司磷酸铁锂业务局面或将快速打开。

高工锂电调研显示，近期头部正极材料企业的高压实产品基本处于满产满销状态。有熟悉磷酸铁锂产业人士称，磷酸铁锂实际供需呈现高端紧俏、低端过剩的结构性特征，真正能批量生产4代产品的企业屈指可数。

面对行业竞争，金川瑞翔表示将持续优化单晶高电压三元材料核心放量产品性能，聚焦高压实、高功率磷酸铁锂技术升级，并对钠离子电池、固态电池等前沿材料开展系统研发与技术储备，同时通过多渠道合作锁定货源建立稳定原料保障机制，全面提升综合竞争力。

控股股东全“链”协同 产业资本融合路径清晰

股东方面，“背靠大树”是金川瑞翔的关键词。招股书显示，金川科技园直接持有金川瑞翔58.11%股份，系公司控股股东，而金川科技园系金川集团全资子公司，故金川集团为公司间接控股股东（合计持股比例为62.36%），公司实控人为甘肃省国资委。

金川集团是一家世界500强企业，总部位于甘肃金昌，是我国最大、世界领先的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心。目前，金川集团镍产量世界第二，钴产量世界第一，铜产量国内第三，矿产铂族金属产量亚洲第一。

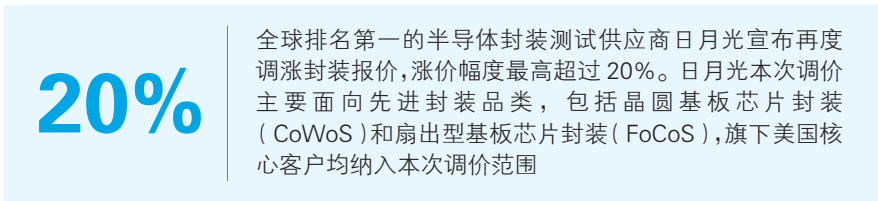
财务数据显示，金川集团2025年实现营业收入4895.98亿元，实现净利润910.2亿元。

金川瑞翔直言，依托金川集团强大的资源储备、完善的产业协同、良好的品牌信誉优势，将为公司产能扩张、客户拓展及长期稳健发展提供坚实支撑。

事实上，在镍钴资源与新能源材料赛道，金川集团正在勾勒产业与资本深度融合的发展蓝图。

除了金川瑞翔，金川集团旗下金川镍钴的IPO进程节奏清晰。2025年3月提交辅导备案，同年6月完成辅导工作。有接近金川集团人士告诉记者，目前金川镍钴IPO正等待交易所受理，已进入上市前关键筹备阶段。

日月光宣布再度调涨封装报价 最高涨幅超过20%



◎记者 李兴彩

据业界消息，7月1日，全球排名第一的半导体封装测试（OSAT）供应商日月光宣布再度调涨封装报价，涨价幅度最高超过20%。

日月光本次调价主要面向先进封装品类，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），旗下美国核心客户均被纳入本次调价范围。

对于调价逻辑，日月光COO吴田玉此前曾在股东会后接受采访时回应称，涨价主要有两方面考量：一是反映原材料价格上涨，这类调价属于刚性必要性的调整；二是覆盖近期大幅提升的资本开支对应的投资成本。公开数据显示，日月光此前年度资本开支约为20亿美元，2025年已提升至53亿美元，2026年进一步上调至85亿美元，未来不排除继续上调。

上海证券报记者了解到，国内先进封装厂商方面，长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子均在上半年进行了不同幅度的涨价。

“日月光打头阵，其他封装厂有望进一步跟进涨价。”展望先进封装下半年价格趋势，多位半导体封装业内人士表示，市场需求在持续增长，叠加原材料价格上涨，下半年继续涨价是大概率事件。

从全球市场来看，随着AI算力持续呈现爆发式增长，摩尔定律逼近物理极限，先进封装成为延续芯片性能提升、支撑AI算力爆发的核心赛道，产业战略地位空前提升。

市场调研机构Yole表示，2025年全球先进封装市场规模为540亿美元，预计到2031年将增长到1090亿美元，

实现规模倍增。其中，2.5D/3D封装将成为行业增长主力，核心驱动力来自AI产业高速发展。

当前，由于AI对大算力芯片、HBM需求持续强劲，2.5D/3D先进封装产能持续紧缺，业内普遍预期供需紧张格局将延续至2027年下半年。

机遇当前，海内外半导体封装厂均在加速新建、扩建先进封装产能。吴田玉表示，日月光正以前所未有的扩产速度，同步推进建设15个新厂区，首个面板级封装大规模生产线即将在今年底实现量产。

据记者不完全统计，长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子等A股半导体封装厂已密集宣布扩产计划，合计投资接近350亿元（其中，华天科技以南京工厂二期100亿元投资计算）。

最新的扩产案例来自甬矽电子。公司6月27日披露，为抓住行业发展机遇，进一步提升公司整体实力和市场占有率，公司拟在中意宁波生态园投资建设“微电子高端集成电路IC封装测试三期项目”，计划总投资103亿元。

“国产半导体封装有望借本轮市场需求和扩产，进一步提升技术实力和产业发展水平，加快追赶上国际先进水平。”有半导体封装业内人士表示。

中国半导体行业协会副秘书长兼封装分会秘书长徐冬梅介绍，历经20余年深耕，中国半导体封装产业从“跟跑”到“并跑”，实现历史性跨越。国内龙头封装企业在全球份额稳步提升，长电科技、通富微电、华天科技等公司稳居全球前十；先进封装产能加速释放，2.5D/3D、Chiplet、Fan-out等技术从实验室走向大规模量产。